

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他
参与单位名称	线上参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者： 华泰证券、中信证券、招商证券、平安证券、长城证券、恒泰证券、南京证券、天风证券、华源证券、东方财富证券、兴业证券、国联证券、山西证券、广发证券、方正证券、东北证券、宝盈基金、苏州一典资本、中国国际金融、上海敦颐资产、天津瑞兴投资、北京橡果资产、上海胜帮私募、广西赢舟管理、上海德汇集团、深圳辰禾投资
时间	2025 年 4 月 28 日
地点	线上及网络互动
上市公司 接待人员姓名	董事长：张兵 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 财务总监： 吕敏 独立董事：李挺 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司管理层介绍 2024 年度及 2025 年一季度经营情况 1、公司整体经营情况：受益于国内半导体市场的整体复苏，公司把握市场机遇，聚焦半导体业务，营业收入实现稳步增长，2024 年，公司

实现营业收入 4.32 亿元，同比增长 20%，主要原因是公司在先进封装领域表现出良好的增长趋势，营业收入增长 42.24%，带动总体收入实现增长。其中电镀液及配套试剂同比增长 9.67%，光刻胶及配套试剂同比增长 37.68%。归母净利润 3347 万元，同比增长 2.51%。2024 年研发投入 4,590.17 万元，较 2023 年增长 1,321.39 万元，增长比例 40.42%；研发投入占营业收入的比例为 10.62%，同比增加 1.54 个百分点。

2、公司产品进展情况：

在电镀液及配套试剂方面：公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现高端应用领域的市场突破。

公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品目前处于产品认证后期阶段；5-14nm 先进制程的超高纯硫酸钴基液和添加剂在客户端测试进展顺利，晶圆制造铜制程用清洗液已进入量产放大阶段。电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技、通富微电实现稳定供应，电镀锡银添加剂已通过长电科技的严格认证并取得小批量订单；先进封装用电镀铜添加剂正处于批次稳定性验证阶段。

在光刻胶及配套试剂方面：先进封装负性光刻胶：产品已覆盖多家主流封装厂，市场渗透率持续提升。后续公司将进一步丰富产品型号，以实现全品类覆盖，不断巩固和扩大在该领域的市场份额。晶圆领域 PSPI 光刻胶：公司自主研发的正性 PSPI 光刻胶成功获得主流晶圆厂首个国产化订单，打破了美日企业在该领域的长期技术垄断，成为国内首家实现该材料进口替代的企业。自 2024 年第三季度开始逐步量产，预计 2025 年将逐步实现规模化出货。同时，公司在 PSPI 光刻胶方面同步布局了负性 PSPI 和高感度化学放大型 PSPI，2025 年计划继续推进 PSPI 产品在先进封装和晶圆厂商的产品认证工作。晶圆 ICA 化学放大光刻胶：在客户端验证测试顺利，部分指标优于国际厂商对标产品，具备良好的市场应用前景。OLED 高感光刻胶：用于 OLED 背板阵列黄光工艺制程，在客户端测试中。在 OLED 领域，公司与京东方就未来合作方向及战略规划达成共识并签署合作协议。双方将进一步深化技术合作研发，共同致力于打造创新产品，推动关键材料国产化进程，实现半导体显示材料自主可

控，提升产业整体价值。高厚膜 KrF 光刻胶：公司已组建国内外专家团队布局 KrF 光刻胶产品，公司高厚膜 KrF 光刻胶目前处于实验室研发阶段，力求填补国内空白，为提升我国半导体光刻胶技术水平贡献力量。

3、2025 年第一季度经营情况：公司 2025 年第一季度营收 1.26 亿元，同比增长 54.13%；扣非归母净利润 664 万元，同比增长 84.39%，主要是公司在各领域的收入都呈现稳步增长，同比增长 42.00%，且 INOFINE 进入合并体系，总体实现营业收入 54.13%的增长。

二、问答交流环节

问题一：公司本期盈利水平如何？

答：您好，公司 2025 年第一季度营业收入 1.26 亿元，同比增长 54.13%，归母净利润 756 万元，同比增长 0.7%，扣非归母净利润 664 万元，同比大幅增长 84.4%，主营业务盈利能力提升显著。毛利率 26.56%，较 2024 年全年略有回升；经营活动现金流净额 1,099.68 万元，经营活动现金净流出较上年同期减少明显。本期盈利水平总体稳健，归母净利润微增，扣非净利润和现金流的大幅增长表明核心业务盈利能力和经营效率提升。

问题二：海外市场发展情况如何，未来是否有进一步拓展海外市场的计划？

答：目前公司正加速推进海外供应链布局与渠道建设。通过与马来西亚子公司 INOFINE 的融合，引进了本土的具备海外资源与经营管理经验的团队，为公司布局海外市场奠定了基础。2025 年起 INOFINE 纳入公司合并报表范围，东南亚及其他海外业务将成为公司未来新的业务增长点。

问题三：公司之后的盈利有什么增长点？

答：公司未来的盈利增长点主要体现在产品 and 市场两个方面：（1）产品方面，公司在先进封装、晶圆制造等领域将持续发力，随着先进制程的电镀液及添加剂以及各类型的光刻胶在下游客户测试认证通过，销售收入有望实现持续增长；（2）市场方面，公司将以收购 INOFINE 为契机，持续布局东南亚市场，包括马来西亚在内的东南亚市场将成为公司未来盈利增长的重要部分。

问题四：公司在并购 INOFINE 后，如何整合其资源以提升整体竞争力？

答:公司已制定详细的业务整合计划，明确将 INOFINE 的各项职能融入公司各部门的管理架构，全力推动双方在业务、市场等方面的深度融合，以提升整体组织效能。通过此次并购，公司成功引进具备海外资源与经营管理经验的本土团队，为公司进一步拓展海外市场奠定了坚实基础。未来，公司将充分发挥自身的技术优势、品牌优势、产业链协同优势以及系统化服务优势，持续提升在国际半导体市场的影响力与竞争力，与同行业国际企业展开更有力的竞争。

问题五：公司 2024 年研发投入同比增长 40.42%，主要投入在哪些方向？未来是否有计划进一步加大研发投入比例？

答:2024 年公司研发投入同比增长 40.42%，主要投入在先进封装及晶圆制造领域的电镀液和光刻胶等产品，尤其光刻胶等高端及“卡脖子”产品。主要产品包括：晶圆制造 5-14nm 制程超纯硫酸钴、28nm 制程大马士革电镀铜添加剂、PSPI 光刻胶、高厚膜 KrF 光刻胶；先进封装用电镀铜添加剂、电镀锡银添加剂等。公司制定了明确且可持续的投入计划，保持每年研发投入占营业收入的比例超过 10%，以支持产品创新。

问题六：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答:公司 2025 年第一季度营业收入 1.26 亿元，同比增长 54.13%，归母净利润 756 万元，同比增长 0.7%，扣非归母净利润 664 万元，同比大幅增长 84.4%，主营业务盈利能力提升显著。毛利率 26.56%，较 2024 年全年略有回升；经营活动现金流净额 1,099.68 万元，经营活动现金净流出较上年同期减少明显。公司本期业绩总体稳健，归母净利润微增，扣非净利润和现金流的大幅增长表明核心业务盈利能力和经营效率提升。

问题七：行业以后的发展前景怎样？

答:随着国内半导体行业的需求增长以及产业链转移的影响，行业的景气度呈现持续复苏态势，未来有望随着整体经济的企稳而逐步回暖，这可能带来更多机会，推动国内半导体企业在全市场中的竞争力提升。同时，伴随 AI、物联网等前沿技术兴起，半导体行业迎来新需求增长点与发展机遇，国家也出台扶持政策，国内半导体制造厂商对关键原材料国产化需求迫切，为半导体材料企业带来市场契机。

	问题八：请问公司在半导体材料领域的战略布局是什么？如何应对行业内的竞争和挑战？ 答：公司在半导体材料领域的战略布局主要体现在产品和市场两个方面。产品布局方面，公司坚持“一主两翼”的发展战略，“一主”是半导体电镀光刻，包括先进封装和晶圆制造领域；“两翼”分别是半导体显示和光伏新能源领域；公司将在“一主两翼”发展战略的指导下，持续深入开展技术攻坚与产业布局；市场布局方面，公司将持续加大海外市场的开拓，以东南亚市场为跳板走出国际化的第一步。公司将在坚持战略布局不动摇的基础上，持续深入开展技术攻坚，在先进封装及晶圆制造领域的电镀液和光刻胶等产品，尤其光刻胶等高端及“卡脖子”产品领域建立自身护城河，以应对行业内的竞争与挑战。 问题九：公司 2024 年应收账款增长明显，是否有加强应收账款管理的措施？ 答：2024 年末公司应收账款有所增长主要系销售收入增长所致。公司下游客户主要为国内知名半导体封测厂商、晶圆厂商及新型电子元件厂商，下游客户回款情况良好，期后回款情况正常。未来公司将继续加大应收账款的管理力度。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 29 日